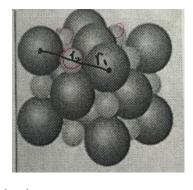
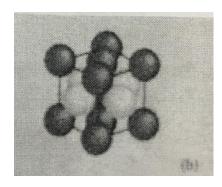


- 一、解释下列术语并进行选择,每题6分。
- 1、电子化合物:MgCu2 相和 CuZn 相哪个是电子化合物?
- 2、无规线团模型:是用来描述金属材料,无机非金属,高分子材料的?
- 3、玻璃化温度:冷速越快,玻璃化温度越高还是越低?
- 4、组分过冷:其他参数固定时,液相扩散系数大的合金容易出现组分过冷还是扩散系数小的?
- 5、Schmidt 因子(取向因子): <100>方向拉伸的取向因子大还是沿<124>取向因子大?
- 6、再结晶温度;AI 和 Fe 谁的再结晶温度高?
- 7、脱溶惯序: Al-2%Cu 和 Al-4%Cu 哪个脱溶速度快?

二、晶体结构

1、如图为两种 A-B 二元合金金相晶胞 (类似于 NaCl 和 CuAu 结构), 分别抽象出其空间点阵结构并写出结构基元。





(a) (b)

- 2、在体心立方中的(112)面上画出(111⁻)方向。若以(111⁻)为晶带轴再画出属于它的另一个晶带面并给出晶面指数。
- 3、当右图 AB 原子无序占位时的晶体结构,并说明原因。

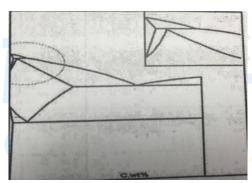


三、晶体缺陷

- 1、点缺陷有哪些种类?
- 2、点缺陷是热力学稳定的吗?为什么
- 3、怎样引入大量点缺陷?并分析它们影响什么物理性能。
- 4、晶界模型有几类?晶界能量随晶界两侧的取向变化的一般规律是什么(从不同类型晶界)分析其原因。

四、铁碳相图







- 1、标出 Fe-C 相图标出各相区的相组成,给出二元等温反应
- 2、画出800℃各相的自由能成分关系图。
- 3、说明3%的合金由液相慢冷到室温时的变化过程。并计算各组织和各相的相对含量。

五、形变与再结晶

1、写出 FCC 结构的黄铜和 BCC 铁的结构的滑移要素(米勒指数)和黄铜的孪生要素。



- 2、简述滑移和孪生的差异
- 3、示意画出黄铜和 Fe 在室温大气压下的轧制组织和再结晶完成后的退火组织。
- 4、再结晶速度(再结晶动力学或再结晶温度)的影响因素有哪些,简述其规律。
- 六、扩散与相变。
- 1、简述影响扩散系数的因素(要说明其规律)
- 2、简述 AI-4%Cu 合金时效强化全工艺,各阶段发生的组织变化(含脱溶惯序)。 给出最佳时效温度时的性能与时间变化曲线(硬度或强度)。
- 3、如果在相变前对上述过饱和相实施显著的塑性变形,分析可能对时效析出时间的影响和对析出相形态的影响。这些变化是有利的还是不利的?

